

次のJPCA規格については、事務局（標準化グループ：std2@jpc.a.org）までお問い合わせください。

#### 電子回路基板

Printed Wiring Board（規格番号：JPCA-PB01-2004）
Standard on Device Embedded Substrate Terminology / Reliability Test / Design Guide - Edition 4 -（規格番号：JPCA-EB01-2011）
Standard on Device Embedded Substrate Data Format - Edition 1 -（規格番号：JPCA-EB02-2011）
フレキシブルプリント配線板実装ガイド（規格番号：JPCA-FJ01-2001）
HDIプリント配線板（規格番号：JPCA-HD01-2003）
HDI Printed Wiring Boards（規格番号：JPCA-HD01-2003）

#### 光電子回路実装（光配線板）

プレーナ導波路リジッド光配線板の詳細規格（規格番号：JPCA-PE02-04-02S-2005）
プレーナ導波路リジッド光配線板の試験方法（規格番号：JPCA-PE02-04-04S-2005）
石英系光ファイバを用いたフレキシブル光配線板の配線設計ガイダンス（規格番号：JPCA-PE02-01-09G-2005）
石英ファイバフレキシブル光配線板の詳細規格（規格番号：JPCA-PE02-01-01S-2008）
石英ファイバフレキシブル光配線板の試験方法（規格番号：JPCA-PE02-01-05S-2008）
高分子光導波路の試験方法（規格番号：JPCA-PE02-05-01S-2008）
光導波路を用いた光配線板の寸法測定方法（規格番号：JPCA-PE02-05-02S(2008)）
光配線板の光導通検査方法（規格番号：JPCA-PE02-05-03S(2010)）

#### 光電子回路実装（光配線板用コネクタ）

Detail Specification for Optical Board Connector type SF using glass Fibers（規格番号：JPCA-PE03-01-01S(2005)）
石英ファイバを用いたSF光コネクタの詳細規格（規格番号：JPCA-PE03-01-01S(2003)）
石英系光ファイバを用いた多心直角曲げ光コネクタの詳細規格（規格番号：JPCA-PE03-01-03S(2006)）
Detail Specification for Optical Board Connector type MF using glass Fibers（規格番号：JPCA-PE03-01-04S(2004)）
石英ファイバを用いたMF光コネクタの詳細規格（規格番号：JPCA-PE03-01-04S(2004)）
石英ファイバを用いたPT光コネクタの詳細規格（規格番号：JPCA-PE03-01-06S(2005)）
PMT光コネクタの詳細規格（規格番号：JPCA-PE03-01-07S(2006)）
SE光コネクタの詳細規格（規格番号：JPCA-PE03-01-08S(2006)）
マルチモードファイバ用MT-PIコネクタの詳細規格（規格番号：JPCA-PE03-01-09S(2007)）
低曲げ損失光ファイバを用いた多心直角曲げ光コネクタ詳細規格（規格番号：JPCA-PE03-01-10S(2008)）

#### 光電子回路実装（光モジュール）

Generic rules for Optoelectronic Modules（規格番号：JPCA-PE04S/JPCA-PE04-01-01S/JPCA-PE04-02-01S(2004)）
OEモジュール通則/OEモジュール用基板総則/OEモジュール実装インタフェース規格総則（JPCA-PE04S(2004）/JPCA-PE04-01-01S(2004）/JPCA-PE04-02-01S(2004)）
PT光モジュールの詳細規格（規格番号：JPCA-PE04-02-01-02-01S(2005)）
OEモジュールの平行平板櫛型ヒートシンクを用いた冷却設計ガイダンス（規格番号：JPCA-PE04-02-03-05G(2005)）
光コネクタをインタフェースとするOEモジュール種別総則（規格番号：JPCA-PE04-02-01-02S(2006)）
光バックプレーンのDS配線接続規格（規格番号：JPCA-PE05-02-02S(2008)）
BPI型光バックプレーン実装インタフェース規格（規格番号：JPCA-PE05-02-02S(2011)）
多心直角曲げ光コネクタを用いた光バックプレーンの性能規格（規格番号：JPCA-PE05-02-03S(2011)）

#### 基板材料（試験方法）

プリント配線板用銅張積層板フェノール採集法 Phenol collection method for copper-clad laminete（日本語/英語併記）（規格番号：JPCA-ES07-2007）
プリント配線板用銅張積層板試験方法 比誘電率及び誘電正接 A test method for copper-clad laminates for printed wiring boards dielectric constant and dissipation factor (500MHz to 10GHz)（日本語/英語併記）（JPCA-TM001-2007）
ビルドアップ配線板（用語）（試験方法）（規格番号：JPCA-BU01-2007）
フレキシブルプリント配線板用銅張積層板試験方法 Test methods of copper laminates for flexible printed wiring boards（規格番号：JPCA-TM002-2009）
ハロゲンフリー銅張積層板試験方法（日本語/英語併記）（規格番号：JPCA-ES01-2003）
ふっ素樹脂銅張積層板のマイクロ波誘電特性の試験方法（規格番号：JPCA-FCL01-2006/JFIA-FP001-2006）

#### 基板材料（個別規格）

ハロゲンフリープリント配線板用銅張積層板（日本語/英語併記）（規格番号：JPCA-ES02~06-2007）
プリント配線板用銅張積層板ーガラス布基材エポキシ樹脂（規格番号：JPCA-CCL14-2005）
多層プリント配線板用銅張積層板ーガラス布基材エポキシ樹脂（規格番号：JPCA-CCL34-2005）
プリント配線板用銅張積層板ー耐燃性高周波用ガラス布基材銅張積層板（規格番号：JPCA-HCL01-2009）

#### 資機材

プリント配線板加工用ドリルビットカセット及びルータービットカセット Drill-bit-cassette and Router-bit-cassette for Printed Wiring Board processing（日本語/英語併記）（規格番号：JPCA-ME-DC01-2002）
--